



※この資料は 2006 年 7 月 6 日に米国で発表された報道資料をもとに和訳編集しています

報道関係者各位

2006 年 7 月 10 日

Soitec、SOI およびその他の加工基板の需要増に応える 戦略的かつ世界的な事業拡張計画を発表

*～フランスの研究開発体制および生産能力を拡張、
シンガポールの新工場を通じて業界でのグローバル・プレゼンスを強化～*

シリコン・オン・インシュレータ(SOI)基板およびその他の加工基板の製造で世界をリードする Soitec (パリ Euronext 上場) は本日、SOI およびその他の加工基板への世界的な需要増に応えるための新たな事業拡張・開発戦略を発表しました。この目的に向けて、Soitec はフランスにおける現在の生産能力を拡張するとともに、シンガポールの新工場を通じて業界でのグローバル・プレゼンスを高めていきます。これらの戦略的投資は、売上と収益性の良好な見通しに支えられたものであり、Soitec の世界市場におけるシェア、および技術的リーダーシップを一層高めることが目的です。

Soitec の社長兼最高経営責任者(CEO)であるアンドレ=ジャック・オーバートン=ハーブ (André-Jacques Auberton-Hervé) は、次のように述べています。「当社の戦略的投資計画は、まず半導体業界が求める加工基板技術を開発し、次にお客様の要望に応じて生産能力を拡張するというコンセプトに基づいています。CEA-LETI (仏原子力庁電子・情報技術研究所) との長年にわたる研究連携と、グルノーブルを拠点とする周辺の官民双方との揺るぎないパートナーシップが、今後も当社のリーダーシップを支えるでしょう。継続的な投資により、当社は量産市場へ対応し、また電子システムの技術的革新に寄与して参ります。当社は、アジアのファンドリィを含めた世界中の半導体メーカーからの需要増に応えるため、シンガポールの新工場を通じて世界的な生産能力の拡張に取り組みます。これにより Soitec 製品は、お客様が必要な時に必要な場所で、大量に入手することが可能になります」

＜フランスの生産・研究開発拠点を拡張＞

Soitec は 2006 年 3 月現在、ベルナン工場に総額 3 億 5,000 万ユーロを超える投資を行っています。最終的な投資予定額は 5 億ユーロを超え、従業員数は約 1,000 人となる見込みです。Soitec グループは、今年上半期中にベルナン第 2 工場に 2 つの 300mm ラインを増設します。生産能力と研究開発事業を拡張し、最近買収したグルノーブルの TraciT

Technologies 社の事業を支援するため、ベルナンの工場に隣接したクリーンルーム(1,300 平方メートル)を MEMSCAP 社(Euronext:MEMS)から約 1,300 万ユーロで取得しました。これにより、Soitec による 300mm ウェーハの最大生産能力は、現在の年間生産能力 72 万枚から、約 100 万枚まで増加する見込みです(中期的予測)。

Soitec は、ベルナンにおける戦略的な研究開発投資プロジェクトを通じて、今後も世界の半導体業界に革新的な加工基板を提供していきます。Soitec と GEA-LETI の NanoSmart 共同プロジェクトは、Soitec グループにとって最も新しく、恐らくは最も大きな可能性を有するプロジェクトです。フランス政府は、これをフランス国内だけでなく欧州と半導体業界にとって重要なプロジェクトであると認識しています。プロジェクトの総予算は 5 年間で 1 億 7,000 万ユーロとなっており、欧州委員会の承認後、Soitec は約 6,000 万ユーロ、GEA-LETI は約 2,000 万ユーロの政府補助金と融資を得る見込みです。また、このプロジェクトは、Soitec 独自の Smart Cut™テクノロジーの新たな用途を探るため、5 年間で 100 人以上の研究者を新規採用します。このプロジェクトにより、Soitec の技術的進歩が促進されるとともに、同社のライセンス戦略を支える先進的な加工基板の新基準が生まれるでしょう。さらに、Soitec は最近、他の開発プロジェクトについても、地方自治体から支援の意向を確認しています。

＜シンガポールに生産拠点を開設＞

ベルナンで進行中の拡張事業に加えて、Soitec はシンガポールに最新の 300mm SOI 工場(通称 Fab 3)の建設を決定しました。新工場の起工は 8 月下旬を予定しており、土地面積は 2.7 ヘクタール、クリーンルーム面積は 4,000 平方メートル以上です。更に Soitec は、将来的な拡張の必要性に向けて、土地も確保しています。Fab 3 のフル稼働時における総投資額は、3 億 5,000 万ユーロに達する見込みで、生産開始は 2008 年中頃です。ウェーハの最終的な生産能力は年産 100 万枚を見込んでおり、これによって市場ニーズへの対応が可能となります。2009 年までには、約 500 人の従業員を擁する設備となる見込みです。

シンガポール経済開発局局長のテオ・ミン・キアン(Teo Ming Kian)氏は、シンガポールの電子産業の一員として Soitec を迎えることを歓迎し、次のように述べています。「SOI 基板の製造で世界をリードする Soitec が、フランス以外で最初となる製造拠点として、数ある候補地の中からシンガポールを選んでくれたことを非常に嬉しく思います。最先端技術を誇る Soitec の設備は、シンガポールにおける半導体エコシステムのレベルの高さを反映するものであり、その一層の活性化をもたらしています。シンガポールは Soitec と、強力かつ持続的な関係を築けることを楽しみにしています」

オーバートン=ハーブは、次のように述べています。「シンガポールのパシルリス・ウェーハ・ファブ・パークに最先端の設備を新設することは、Soitec にとって重要なマイルストーンとなります。ドル建て地域の工場を持つ機会が得られることで、当社は、グローバル規模で競争力を高めることができると確信しています。シンガポールは、地域内の主要顧客やパートナーの皆様と強力な関係を築けられる環境であり、当社の開発戦略を急速な成功へと導かせます。SOI のさらなる量産化が進み、有力半導体メーカー各社が引き続き次世代機器に SOI 技術を活用し、電子機器のマスマーケットに対応している状況の中、世界中のお

お客様が当社の SOI 技術やプロセスノウハウをより迅速かつより簡単に入手することが可能になることは、非常に重要なポイントです」

オーバートン=ハーブは、次のように結論づけています。「グローバルな事業拡張計画が進行することで、投資家の皆様に対する価値の創造と、革新的な強みを活かしたライセンス戦略の展開を最高のものにできることを嬉しく思います。当社はこのほど、増資が成功したことにより、目標の実行に必要な財源を確保できました。このような形で当社をサポートして下さる投資家の皆様には、非常に感謝しています。また、今回の事業拡張を着手する上で欠くことのできない自信と今後の見通しを与えてくださったお客様のサポートにも感謝しています」。オーバートン=ハーブは、顧客の1社がこのほど、契約の更新を行ったことも付け加えました。これは、金額にして1億8,000万ドル、期間にして2006年7月～2007年12月の契約更新であり、このように、顧客の購入計画が上方修正されていることで、今後の見通しが強化されています。また、これによって、2006-2007会計年度の為替レートが当社にとって不利であったにも関わらず、4億ユーロという初期の見通しがより確実になったほか、長期的な成長の見通しがより強力なものとなりました。

<Soitec・グループについて>

Soitec・グループ(本社所在地:フランス、ベルナン)は、現在の最先端エレクトロニクス製品とナノテクノロジーの基礎となる加工基板の開発・供給で世界をリードしています。シリコン・オン・インシュレータ(SOI)や歪シリコン・オン・インシュレータ(sSOI)を含む包括的な加工基板は、業界のデファクト・スタンダードである Soitec 独自の Smart Cut™テクノロジーによって製造されています。Soitec は、その強力なグローバル・プレゼンス、特許技術、業界をリードする製造能力により、世界中の消費者が志向する小型・省電力・携帯型の電気製品にとって不可欠な性能/パワー・アドバンテージの拡大に寄与しています。Soitec の株式及び転換社債はパリの Euronext に上場されています。その他詳しい情報につきましてはウェブサイト、www.soitec.com をご覧ください。

※Smart Cut および UNIBOND は S.O.I. TEC Silicon On Insulator Technologies の商標です。

<このリリースに関するお問い合わせ先>

Soitec Asia (株)

兵頭 富雄

TEL: (03) 5221-7120

Email: soitecasia@soitec.com

広報代理店: オグルヴィ PR

担当: 齊藤真帆

TEL: 03-5791-8804

Email: maho.saito@ogilvy.com